



技术要求:

1. 热处理质量符合 JB/T 1255 标准, 垫片经 200℃(S0) 回火, 硬度 59 ~ 64HRC, 金相组织马氏体 1~4 级;
2. 组装时残留异物量在 0.2mg 以下 (采用网孔尺寸为 10 μ m 滤网称重), 最大颗粒物尺寸 $\leq 600\mu$ m;
3. 零件确保无飞边、毛刺、裂纹、锐边、锈蚀的外观缺陷;
4. 未注尺寸公差按照 GB/T 1804 m 级执行。

	垫片	AS27×46×3
	GCr15	